

●DFN1010-4C(DAF)パッケージ許容損失(JESD51-7) ※Tjmax=150°C

DFN1010-4C パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 測定条件(参考データ)

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pb フリーはんだ

実装基盤：4層基板 76.2mm×114.3mm (片面約 8700

mm²) に対して銅箔面積

1層目：銅箔無し (信号層の為)

2層目：74.2mm×74.2mm (放熱板と接続有)

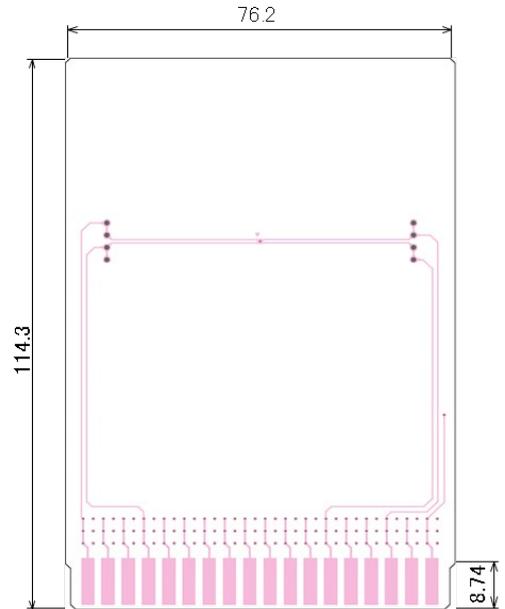
3層目：74.2mm×74.2mm (放熱板と接続無)

4層目：銅箔無し (信号層の為)

基板材質：ガラスエポキシ (FR-4)

板厚：1.6mm

スルーホール：φ0.3mm



評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失-周囲温度特性

基板実装(Tjmax=150°C)

周囲温度(°C)	許容損失 Pd (mW)		熱抵抗(°C/W)
	Ta max=125°C	Ta max=150°C	
25	830	830	150.60
125	159	159	
150	0	0	

